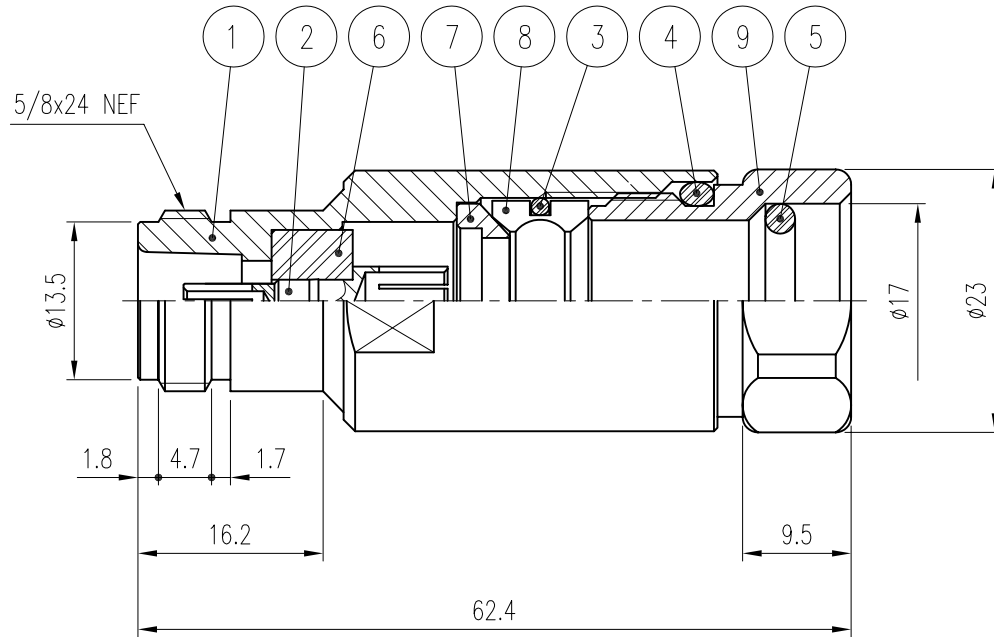


ST										수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										1	도면 양식 변경	손윤호	최영호	2003. 1. 8.
ST(개선)														



9	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00120-5/2 (P8049)
8	INSERT	2	MBsBD	Silver Plate	DIS00100-5/1 (M8048)
7	INSERT	1	MBsBD	Silver Plate	DIS00099-5/1 (M8042)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01043-N/1 (H8160)
5	GASKET	1	SILICON		DGK00041-N/1 (G5009)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00140-N/1 (G8029)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00098-N/1 (G8028)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01142-5/2 (E8218)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01494-5/2 (D8237)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2002. 6. 7.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. 1/2" F N-J		
	승인						
재질	검도						
열처리	재도						
보호피막처리	작성부서 연 구 소				A4	도면	CNO0462-7/2
	작도	NS	단위 mm	중량			K345-241-000